

リワーク可能なアンダーフィルにより、ICパッケージのボードレベルの熱サイクルを強化、Zymet CN-1735

2013年7月17日
ニュージャージー州イーストハノーバー

ザイメットは、0.3mmピッチの極小ピッチのICパッケージのボードレベルの熱サイクル性能を向上させるように設計された、新しいリワーク可能な低CTEアンダーフィル封止材CN-1735を発表しました。CN-1735は、落下および曲げ試験性能の堅牢性も向上させます。

従来のリワーク可能なアンダーフィルのCTEは64~75 ppm/°Cであり、ボードレベルの熱サイクル性能が犠牲になった場合でも、主に落下試験と曲げ試験の性能を向上させるために使用されます。CN-1735のCTEは40ppm/°Cで、サーマル・サイクル性能が向上しています。

低CTEアンダーフィルは、通常、再加工できないか、再加工が非常に困難です。CN-1735は簡単に作り直すことができます。リワークは、170°C~180°Cの高温を使用してアンダーフィルフィレットを除去することによって行われます。次に、BGAは、リフロー温度まで加熱した後、ボードから持ち上げられます。アンダーフィルの残留物は、170°C~180°Cで簡単に削り取られます。

ザイメットは、マイクロエレクトロニクスおよび電子接着剤および封止材のメーカーです。その製品には、ダイアタッチ接着剤、基板接着剤、UV硬化型グロブトップおよびキャビティフィル封止材、アンダーフィル封止材などがあります。

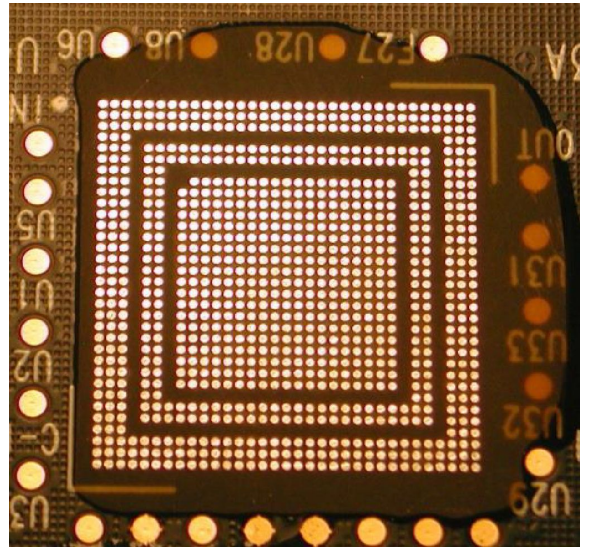


図1. リワーク可能なアンダーフィル